

## 武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

# 关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的说明

武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式，向武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波铖丰皓企业管理有限公司等 3 名交易对方收购武汉生一升光电科技有限公司（以下简称“标的公司”或“生一升”）100%股权，并募集配套资金。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的规定，科创板上市公司实施发行股份购买资产的，拟购买资产应当符合科创板定位，所属行业应当与科创板上市公司处于同行业或者上下游，且与科创板上市公司主营业务具有协同效应，有利于促进主营业务整合升级和提高上市公司持续经营能力。

公司董事会经审慎判断，本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的相关规定，具体如下：

### 一、标的公司符合科创板定位

标的公司致力于成为数据通信领域最优器件解决方案提供商，主要从事各类中高速光器件产品的研发、生产、销售和服务，主要产品包括 CWDM 及 LAN WDM AWG 器件、并行光器件（MT-FA）和光纤阵列器件等产品解决方案，具有小尺寸、稳定性和可靠性高以及低成本等特点，主要应用于数据中心和电信传输等领域。AWG 器件和并行光器件主要负责光模块中光信号的传输，为高速光模块中的核心光器件，其性能决定了光传输网络的承载与运输能力。

标的公司持续深化高速光器件整体解决方案的研发设计和工艺开发能力，形成了光学芯片冷加工技术、高精度光学芯片耦合技术、FA 光纤阵列设计制造技术和并

行光学仿真设计及制造等核心技术，能为客户提供多种应用场景的光器件整体解决方案，助力终端数据中心产业持续发展。

根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，标的公司归属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C397 电子器件制造”之“光电子器件制造”。根据国家统计局公布的《战略性新兴产业分类（2018）》，标的公司属于“1 新一代信息技术”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。

因此，标的公司业务符合国家科技创新战略，根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，属于“新一代信息技术领域”的行业分类。

## 二、标的公司与上市公司处于同行业，具有协同效应

### （一）标的公司与上市公司处于同行业

上市公司主要从事光纤陀螺核心器件光纤环及特种光纤相关产品的研发、生产和销售，主要产品为光纤环器件、特种光纤和新型材料等，主要应用于惯性导航和光通信等领域。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，上市公司归属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C397 电子器件制造”之“光电子器件制造”。

标的公司则立足光通信领域，主要从事各类中高速光器件产品的研发、生产、销售和服务，主要产品包括 AWG 器件、并行光器件（MT-FA）和光纤阵列器件等产品解决方案。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，标的公司归属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C397 电子器件制造”之“光电子器件制造”。

综上，标的公司与上市公司处于同一行业。

### （二）标的公司与上市公司主营业务具有协同效应

经过多年的持续深耕，上市公司已成为光纤环细分行业的领导者和光纤环组件全面解决方案提供商，尤其是在军用惯性导航领域，已拥有较好的市场竞争地位。为紧跟行业发展趋势和更好发挥现有产业潜力，上市公司正在积极布局第三代光纤陀螺光子芯片业务，并以 AI 算力为牵引积极延展通信领域光器件业务，大力开拓非军用市场，持续提升上市公司的经营业绩。

标的公司则主要从事各类中高速光器件产品的研发、生产、销售和服务，与上市公司在业务、技术和市场等方面具有较好的协同效应。

在业务协同方面，标的公司在晶圆级光芯片切割以及端磨加工、保偏光纤 FA 制备以及光芯片与保偏光纤 FA 的高效耦合等方面具备较好的技术和工艺能力，能够较好满足上市公司第三代光纤陀螺光子芯片业务落地需求。同时，上市公司生产的特种光纤（如保偏光纤、弯曲不敏感光纤、多模光纤、空芯微结构光纤和多芯光纤等）和新型材料（如光固化高分子材料）等则可用于标的公司光器件业务，有助于保障标的公司的光纤原料来源、降低生产成本和提高市场竞争力。此外，上市公司正在开发的光纤陀螺光子芯片平台可助力标的公司实现核心部件光芯片的自主研制，借助上市公司统一的光芯片设计、流片、光器件封装测试平台，进一步提升标的公司主业内在价值。

在技术协同方面，标的公司在光无源器件研发和工艺开发过程中，形成了光学芯片冷加工技术、高精度光学芯片耦合技术、FA 光纤阵列设计制造技术和并行光学仿真设计制造等技术，具有优秀的光器件加工和耦合能力，而上市公司正在加强光芯片设计、光器件封装测试能力建设，以及与国内光芯片流片平台构建战略合作关系，双方具有较好的技术互补关系。本次交易将整合双方研发团队和资源，有利于在光器件领域构建光芯片及光器件的设计、制备、耦合、封装测试等完整的技术体系，有助于提升综合研发实力，共同提升行业竞争力。

在市场协同方面，上市公司将通过本次交易快速切入至以数据中心为代表的光通信领域，大幅拓宽上市公司主要产品特种光纤和材料的下游应用行业和客户群体，减少对单一市场的依赖，标的公司也可以借助上市公司多年在军工惯性导航领域内积累的市场渠道和客户资源，加快拓展军品市场。

因此，标的公司与上市公司处于同行业，具有协同效应。本次交易有利于促进上市公司主营业务整合升级并提高持续经营能力。本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的相关规定。

特此说明。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2024 年 11 月 13 日